

苏州国芯科技股份有限公司

2023年1月投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2023-001

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容） </p>
<p>参与单位名称</p>	<p> 天弘基金；易方达基金；中欧基金；华夏基金；博时基金；嘉实基金；华泰证券；汇添富基金；富国基金；广发基金；南方基金；盘京投资；交银施罗德基金；中信证券；蜂巢基金；天安人寿；新华资产；宝盈基金；诺安基金；华宝基金；上海高毅资管；国泰君安证券；中国人保；百年保险资产；中国国际金融；上海景熙资产；汇华理财；淳厚基金；深圳望正资产；上海湘楚资产；苏州君榕资产；广银理财；华商基金；银华基金；建信基金；上海中金资本投资；上海健顺投资；永赢基金；Willing Capital Management Limited；仁桥（北京）资产；方正证券；国信证券；上海致海蓝资产；国投瑞银基金；北大方正人寿；东吴证券；润晖投资；上海南土资产；中加基金；银华基金；英大保险资产；北京源乐晟资产；上海瓴仁私募基金；鹏华基金；宁波幻方量化投资；上海锐至信息技术；华创证券；国泰基金；惠通基金；深圳昭图投资；上海合远私募；平安资产；北京衍航投资；泰康养老保险；西部证券；上海宁泉资产；新华基金；广发证券；上海鹤禧私募基金；磐厚动量（上海）资本；敦和资产；海通证券；中银基金；西部利得；华安基金；工银瑞信；上海明河；万和证券；大成基金；Brilliance Asset Management Limited；财通证券；长安基金；华创证券；敦和资产；西藏合众易晟；长盛基金；平安基金；兴银基金；上银基金；深圳常春藤；中信建投；上海齐泽投资；上海汐泰；上海和谐汇一；上海利幄资管；国寿安保基金；国联证券；中邮创业基金；汇丰晋信基金；泰康资产；恒越基金；中国人寿养老保险；永赢基金；万联证券；上海勤辰；广东盈盛股权投资基金；深圳多鑫投资；上海汐泰投资；金信基金；深圳前海旭鑫资产；上海混沌投资；中海基金；银华基金；深圳博普科技；深圳中欧瑞博投资；中银国际；湘潭东方红股权投资基金；东方证券资管；丰琰投资；鑫元基金；金鹰基金；中融基金；兴业基金；翊安（上海）投资；深圳纽富斯投资；中国国新控股；湖南万泰华瑞投资；敦和 </p>

	资产；朱雀基金；北京致顺投资；凯石基金；华美国际投资；上海远策投资；元大证券投资信托；东吴证券；恒生前海基金；申万菱信基金；中信保诚基金；合众资管；深圳博鸿基金；华润元大基金；北京凯读投资；华登国际投资；北京星石投资；相聚资管；中银基金；青岛伟晟；上海磐稳投资；德邦基金。
时间	2023年1月5日 15:00 2023年1月6日 9:00 2023年1月6日 10:00 2023年1月12日 15:00 2023年1月29日 16:00 2023年1月31日 10:00 2023年1月31日 15:00
地点	线上交流及现场交流
上市公司参加人员姓名	董事会秘书：黄涛先生 证券事务代表：龚小刚先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司参会人员首先介绍了公司 2022 年的情况</p> <p>苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 6 月，至今已有 20 多年的历史，公司于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所科创板上市，是一家聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用的芯片设计公司，可面向国家重大需求和市场需求领域客户提供自主可控的嵌入式 CPU IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，助力关键领域实现芯片层面的安全自主可控，推动国产化替代进程。公司产品主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制以及边缘计算和网络通信三大关键领域。</p> <p>公司始终坚持“国际主流兼容和自主创新发展”相结合的原则，历经二十余年的持续研发、创新与沉淀，基于 M*Core、PowerPC、RISC-V 三种指令集，公司设计完成 8 大系列 40 余款嵌入式 CPU 内核，在嵌入式 CPU 内核多个领域形成较强的技术壁垒。基于自主嵌入式 CPU 核和积累的丰富外围 IP 模块，面向信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域，公司建立了可复用、易拓展的 Soc 芯片设计平台，可实现 14nm 以上多个工艺节点芯片的快速开发，公司全面掌握嵌入式 CPU 的微架构自主设计技术，除了可以实现主流 CPU 核应该具有的指令功能外，还可以根据实际应用需求定制</p>

专用指令。目前，公司在嵌入式 CPU 领域内，多项性能指标已达到国际主流 IP 供应商在嵌入式应用领域产品的同等技术水平，产品品种丰富。公司也会根据市场应用需要持续开发或更新嵌入式 CPU 核技术，目前形成了深厚的嵌入式 CPU IP 储备。

公司分别于 2006 年、2008 年和 2015 年实现累计上百万颗、上千万颗和上亿颗芯片产品的应用。在信息安全领域，公司成功研制了“云”到“端”的安全芯片，覆盖云计算、大数据、物联网、智能存储、工业控制和金融电子等关键领域，以及服务器、汽车和智能终端等重要产品。在汽车电子领域，公司已成功开发车身控制、域控制、动力总成控制、新能源电池 BMS 控制、车联网安全芯片产品，在前述领域实现批量应用，为解决我国汽车产业缺芯问题作出努力。

公司是江苏省集成电路产业技术创新联盟副理事长单位和苏州半导体产业联盟理事长单位。公司先后承担了 5 项“核高基”国家科技重大专项，并且荣获国家科学技术进步二等奖、中国电子学会电子信息科学技术一等奖和江苏省首届科技创新发展奖优秀企业、中国集成电路创新联盟颁发的第五届“IC 创新奖”技术创新奖等多项科技奖项

2022 年，公司预计全年实现营业收入 53,000 万元至 58,000 万元，与上年同期相比，将增加 12,261 万元至 17,261 万元，同比增加 30.10%至 42.37%。预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,500 万元至 11,000 万元，与上年同期相比，将增加 1,480 万元至 3,980 万元，同比增加 21.07%至 56.68%。特别是公司的汽车电子业务增长迅猛，公司的汽车电子芯片实现 400 余万颗的销售，出货量同比增加十倍以上，汽车电子业务的收入实现大幅度增长。

二、投资者就其关心的问题，向公司提出了问题，公司参会人员进行了回复，主要情况如下：

1、请介绍一下 2022 年年度业绩预告情况？

答：经财务部门初步测算，公司预计 2022 年年度实现营业收入 53,000 万元至 58,000 万元，与上年同期相比，将增加 12,261 万元至 17,261 万元，同比增加 30.10%至 42.37%。预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,500 万元至 11,000 万元，与上年同期相比，将增加 1,480 万元至 3,980 万元，同比增加 21.07%至 56.68%。预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,600 万元至 3,600 万元，与上年同期相比，将减少 2,780 万元至 780 万元，同比减少 63.47%至 17.81%。

2、2022 年营业收入获得增长的主要原因是什么？

答：对比上年同期，本报告期内公司持续调整产品结构，抓住行业发展机遇，围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域，积极开拓市场和客户，克服疫情带来的影响，有效保障产能需求，特别是报告期内公司的汽车电子芯片实现 400 余万颗的销售，出货量同比增加十倍以上，汽车电子业务的收入实现大幅度增长，公司整体营业收入实现了持续增长。此外，由于受到 2022 年四季度疫情的影响，公司有多个芯片定制服务项目未能及时获得客户验收，将顺延到 2023 年完成。

3、请问 2022 年大幅增加的研发投入主要投入在哪些方面？

答：为抓住高端汽车电子芯片和高可靠存储芯片国产化替代的机遇，围绕高端汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片等领域，公司进行了高强度的研发投入，并较大幅度增加了研发人员数量，导致本年度研发费用比上年度预计增加 6000 万元左右，增长幅度预计将超过 50%。高强度的研发投入为公司坚守长期主义、保持高质量成长提供驱动力。

4、2022 年收入增长的大致分布情况怎么样？

答：通过目前财务部门初步测算的数据看，2022 年，定制芯片的销售收入有较大幅度的增长，自主芯片销售收入与去年同期基本持平略有增长。其中，汽车电子芯片和云安全芯片业务有较大幅度的增长。定制芯片收入中，先进计算和存储领域的收入有较大幅度的增长。

5、公司对 2023 年的业务是怎么展望和规划的？

答：2023 年，我们将坚守长期主义的发展策略，围绕“头部客户”，树立“客户”第一的理念，服务好客户，继续加强团队建设，紧紧围绕公司汽车电子芯片、信创和信息安全芯片等重点发展方向，推进公司资源优化和聚焦，注重产品技术平台化、流程规范和标准化。在汽车电子芯片领域，继续保持公司中高端车身控制芯片领域的快速发展势头，同时实现新研发的域控制器芯片、混合信号芯片和汽车信息安全芯片的规模化销售，总体确立公司在国内汽车电子芯片领域的领头地位；在信创和信息安全芯片领域，公司将着重发展云安全芯片、先进存储 Raid 控制芯片和边缘计算芯片等系列，做到具有国内领先地位；在定制芯片领域，公司将致力于从定制设计服务收入为主转向以定制量产服务收入为主，注重挖掘和培育信创和工业控制领域头部客户的定制服务。

6、公司在汽车电子领域进展较快的原因是什么？

答：公司在汽车电子领域的研发有较长的历史，公司的技术经过了较长的时间积累

和市场验证，具有较为丰富的研发经验，公司近年来适时根据汽车市场的发展需求不断加大研发和人员投入，努力服务好各类汽车电子领域的客户，不断地满足了客户的需要。

2009年，公司启动面向汽车电子和工业控制芯片的关键技术研发，并推出应用于汽车电子和工业控制领域的嵌入式CPU内核C2002及相应的SoC芯片设计平台。2014年，公司承担了核高基国家重大科技专项项目“车身电子控制器SoC芯片研发与产业化”，推出了适用于车身控制和车辆网关等应用领域的芯片CCFC2002BC。2015年公司启动面向发动机控制应用领域的芯片CCFC2003PT的研发。2017年公司启动第二代发动机控制芯片CCFC2006PT的研制。上述芯片目前均已通过AEC-Q100 Grade 1级测试认证，开始投放市场，实现了我国关键领域的国产化替代。近几年，随着国内汽车产业对汽车电子MCU芯片需求的加大，国产替代和自主可控的迫切性进一步加强，公司也就较为顺利、快捷地进入了市场化的汽车电子领域。同时，公司应用的PowerPC架构指令系统CPU核非常适合汽车生态，在全球汽车电子芯片占有很高的市场份额（PowerPC、Tricore、ARM三足鼎立），对标NXP等公司芯片，容易进入客户。我们运用的PowerPC架构具有较强的兼容性，我们的汽车电子芯片已经在多个领域的汽车中获得一定范围的实际应用。我们的性能和英飞凌、恩智浦的中高端芯片的性能是一致的，并且产品成本控制也比较好。

近年来，公司不断加大对汽车电子领域的投入，适时根据市场环境的变化以及汽车电子领域客户的需求，积极响应客户的诉求，不断研发出符合客户需要的新产品，不断地赢得了客户的信赖。

因此，公司汽车电子MCU芯片业务近年来进展较快，市场反响也较为积极。

7、公司2022年汽车电子的出货量怎么样？目前在研的汽车电子芯片有哪些？相关产品的研发和市场推广进展情况怎么样？

答：2022年，公司汽车电子芯片实现超过400万颗的销售，出货量同比增加十倍以上，汽车电子业务的收入实现大幅度增长，公司正在研发和推向市场的汽车电子芯片有：

(1) 公司成功研发的CCFC2012BC主要应用于中高端车身控制，应用场景包括整车控制、车身网关、安全气囊、无钥匙启动及T-BOX等应用，可实现对国外产品的替代，覆盖新能源车和传统乘用车等。目前下游的涵盖整车客户包括比亚迪、上汽、长安、奇瑞、东风等，预计随着公司产品前装应用增加和影响力增加，芯片的订单及出货增长量会进一步增加。中低端的车身控制芯片2011BC、2010BC也已经研发成功推向市场；

	<p>(2) 汽车动力总成控制领域：公司已研发成功 CCFC2003PT、CCFC2006PT 等型号芯片产品，CCFC2007PT 已经内部测试成功，对标 NXP（恩智浦）MPC5777 的 CCFC3007PT（高端）芯片产品正在设计中，可覆盖传统的汽柴油发动机、新型混动发动机及电动机应用需求。动力总成控制芯片需要更长的时间进行应用验证，公司目前正在和相关厂商紧密合作，争取尽快实现产业化规模应用。目前国内能开展汽车动力总成控制芯片研发的厂商还很少，公司在国内处于领先地位。公司构建了和汽车发动机领域头部客户和动力总成控制模组头部厂商为主的战略合作关系格局，共同定义新产品，实现国产化替代。汽车发动机芯片技术难度大，但市场急需国产化。</p> <p>(3) 汽车域控制器领域：公司已经完成汽车域控制器芯片 CCFC2016BC 的研发和流片，该芯片产品已经内测成功，目前已实现数十万颗的市场销售应用。该芯片的产品定义过程中充分征求了国内头部新能源汽车厂商的意见。同时，我们也正在研发高端的域控制芯片 CCFC3007PT、CCFC3008PT 和 CCFC3009PT 系列。</p> <p>(4) 新能源电池 BMS 控制领域：2022 年 8 月 31 日，公司公告披露了公司成功研发的 CCFC2007PT 芯片产品可以应用于新能源电池管理(BMS)控制芯片，目前公司正在和国内新能源电池厂商一起合作推动应用方案开发，争取尽快实现规模化应用。公司正在开展新一代高性能新能源电池管理控制芯片 CCFC3008PT 的研发，进展顺利。</p> <p>(5) 车规级安全 MCU 芯片：公司已成功开发 CCM3310S-T、CCM3310S-H 和 CCM3320S 等三款汽车电子安全芯片产品，形成高、中、低产品系列，其中 CCM3310S-T/CCM3310S-H 已批量供货，CCM3320S 已完成客户验证和实现小批量应用，主要对标国际领先厂商有恩智浦和英飞凌相关产品，主要应用包括车载 T-BOX 安全单元、车载诊断系统（OBD）安全单元、车联网 C-V2X 通信安全应用等。CCM3310S-T、CCM3310S-H 车规级芯片已获颁国内首批汽车安全芯片可信安全认证证书，经中国汽车技术研究中心有限公司软件测评（天津）有限公司测试，CCM3310S-T、CCM3310S-H 车规级芯片满足 ACS-EAL5+等级要求，达到目前国内安全芯片在汽车行业专业安全认证方面的最高等级。</p> <p>在其他应用领域，公司也开始瞄准汽车电子混合信号类以及专用 SoC 芯片领域国产化替代机会，启动汽车门控混合信号芯片、安全气囊点火芯片和新能源汽车降噪 SoC 芯片等的研发工作。</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2023 年 1 月
----	------------